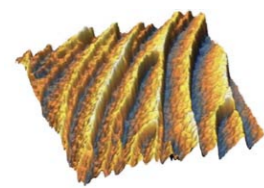
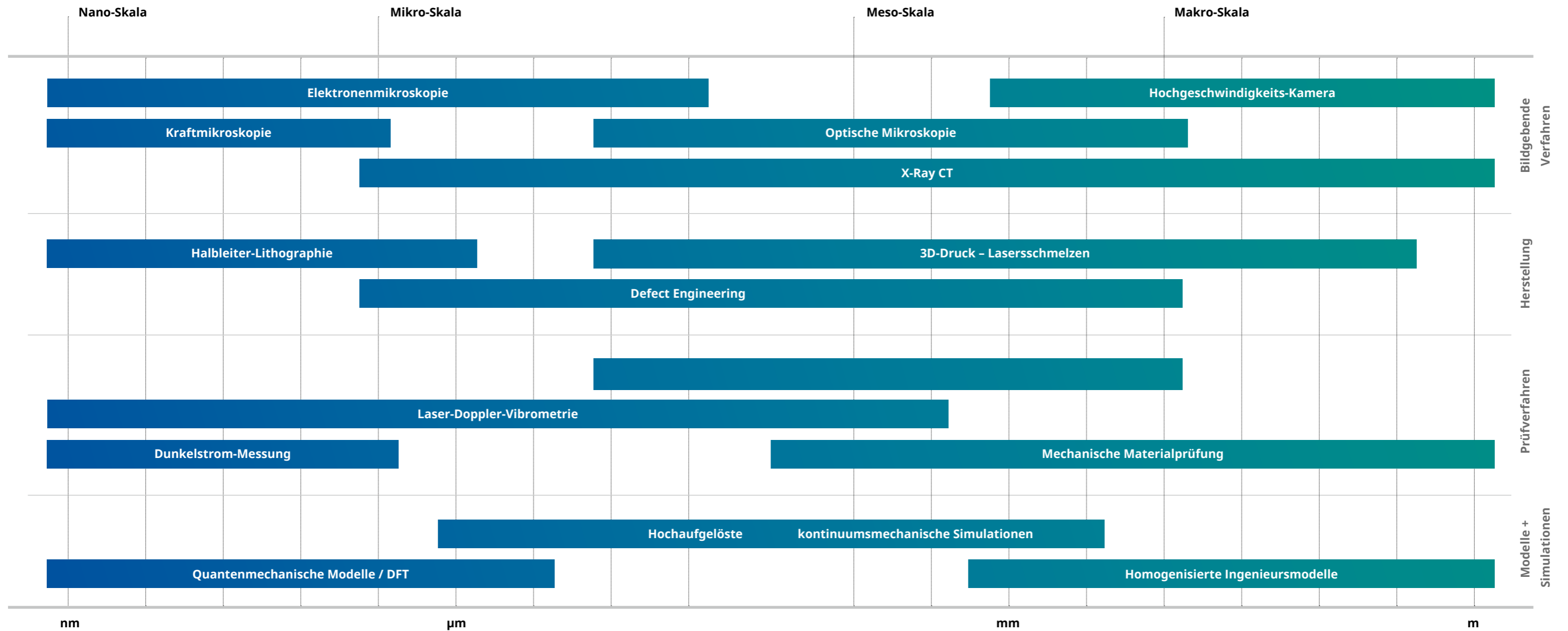
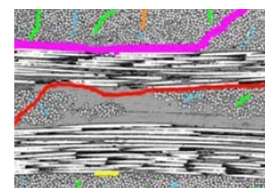


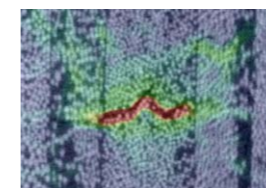
# Maßnahmen und Methoden



**Strukturelle Analyse** Mit Hilfe der Kraftmikroskopie können atomare Stufen an der Oberfläche von Halbleitermaterialien sichtbar gemacht werden.



**Defect Engineering** Defekte und Inhomogenitäten bestimmen die Lebensdauer, sobald die Schwelle der lokalen Festigkeit überschritten wird. Mit ultraschallbasierten Methoden werden diese Einflüsse studiert um robuste nachhaltige Systeme zu ermöglichen.



**Faserverbundwerkstoffe** Sie bestehen aus hochfesten Fasern und einer umgebenden Polymermatrix. Röntgenbasierte Methoden zeigen im Inneren verborgene Defekte und helfen, ihren Entstehungsmechanismus zu verstehen.



**Metamaterialien** Ihre maßgeschneiderten Eigenschaften werden für die jeweilige Anwendung optimiert. Um den Reifegrad der Technologie zu erhöhen, werden prozessbedingte Strukturdefekte charakterisiert.